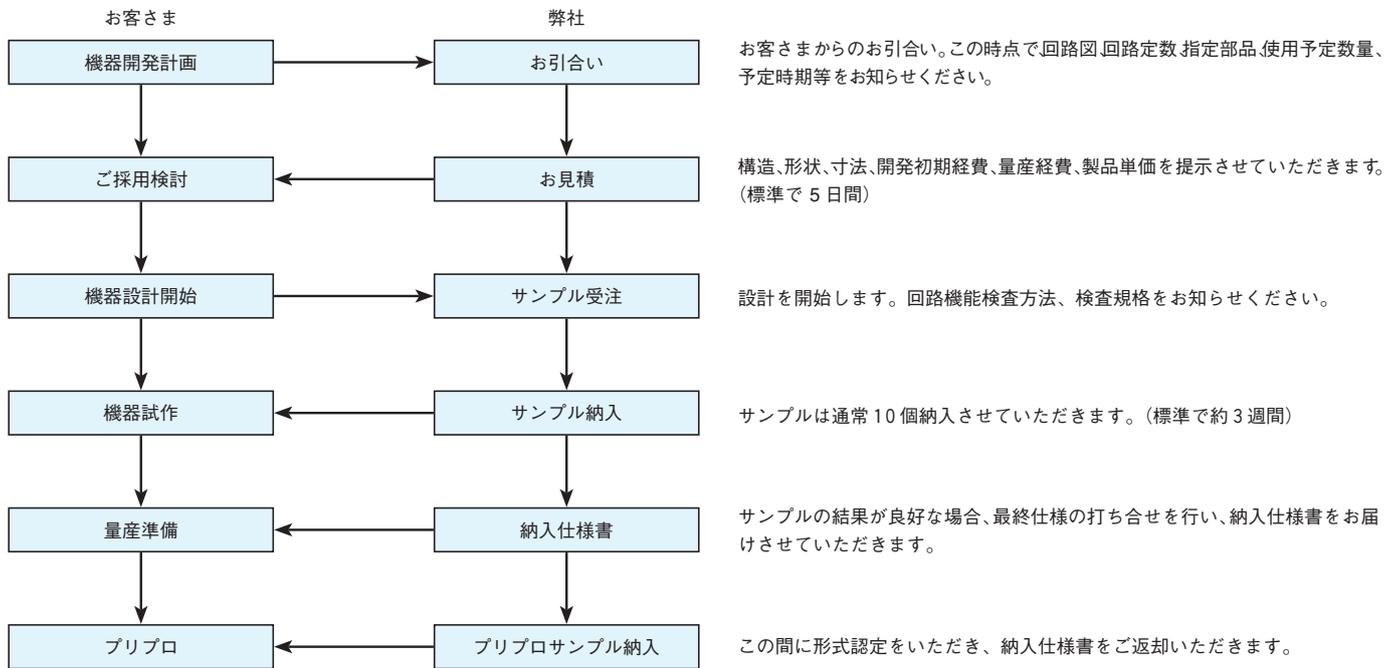


■カスタムモジュールのご案内

お客さまからご提示いただいた回路を目的にあった形状、合理的な構造で、迅速に設計いたします。小形モールド形半導体を使用したタイプ、半導体チップボンディング方法による高密度実装モジュールのいずれにも対応させていただきます。

●開発の手順

カスタムモジュールの開発手順は次の通りです。



●お見積に必要な情報

情報が多いほど、的確なお見積りが出来ます。

	最小限必要な情報	必要な情報	お見積精度を高める情報
回路情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回路図、回路定数と許容差</li> <li>●部品品名、品番、メーカー</li> <li>●部品の温度特性 (必要なもの)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●代替部品</li> <li>●回路機能のご説明</li> <li>●検査仕様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周辺回路</li> <li>●システム機能</li> </ul>
構造情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>●要求形状、寸法</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ピン配置</li> <li>●規格条件 (UL等)</li> <li>●マーキング仕様</li> <li>●外観仕様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用場所周辺のスペース</li> <li>●装置全体の構造</li> </ul>
信頼性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用途</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用環境</li> <li>●品質保証仕様</li> <li>●スクリーニング仕様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●特別契約の有無</li> </ul>
生産情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>●年間ご使用量</li> <li>●量産開始時期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品のライフ</li> <li>●開発計画</li> <li>●新規開発・現行製品の別</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他品番も含めた使用量</li> <li>●過去の使用実績</li> </ul>

●機密事項

カスタムモジュールはお客様の開発段階から設計に必要な情報をお伺いいたします。そのため当然のことながら、回路に関する機密等、開発に関する機密保持の厳守をお約束させていただきます。